

1MM-R-D09-VS-00-F-TBP

ⓧ 请勿在新设计中使用

AMPMODU | AMPMODU 小引脚间距

TE 内部编号 2267465-9

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 18 Position, 1 mm
[.039 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, AMPMODU
Small Centerline

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 18

行数: 2

产品特性

产品类型特性

施加的压力	低
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
装载位置数量	18
信号位置数量	18
板对板配置	平行
可堆叠	否
PCB 安装方向	垂直
位数	18
行数	2



电气特征

工作电压	30 VDC
端接电阻	16 mΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC

主体特性

装配过程特性材料	不锈钢
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.3 mm[.011 in]
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	SMT 引线, 矩形
端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
端子接触部长度	2 mm
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.24 mm[.009 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.1 mm[.003 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

--	--



接合入口位置	底部和顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

行间距	1 mm
连接器高度	3.12 mm
连接器长度	9.6 mm
PCB 厚度（建议）	1.02 – 1.08 mm[.04 – .1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-2331928-9
SCL 1.0 HDR DRV T USP 018 SMT G1 TR

TE 产品编号 2331928-9
SCL 1.0 HDR DRV T USP 018 SMT G1 TBK

该系列中的其他产品 | AMPMODU 小引脚间距

PCB 板端连接器及母端(364)

板对板接头和插座(364)

客户还购买了

TE 产品编号5173280-3
AMPLIMITE.050 CAP ASS'Y (V) 50

TE 产品编号2-2176365-7
RQ 0603 75R 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176453-4
CPF 0201 10K 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号8-2176392-5
RQ 1206 1M0 0.1% 10PPM 5K RL

1MM-R-D09-VS-00-F-TBP

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 18 Position, 1 mm [.039 in]
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, AMPMODU Small Centerline



TE 产品编号2102771-1
DC, 7Row, Center, MULTIGIG RT 2R



TE 产品编号50935
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-1



TE 产品编号1410189-3
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2



TE 产品编号1410187-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号9-146276-0
40 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号2212078-1
MULTI-BEAM CE 2X13 P + 2X24 S, STRADDLE

文档

SCL 1.0 RCPT DR VT 018 SMT G1 TBK

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267465-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267465-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267465-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU 1.0 mm CENTERLINE INTERCONNECTION SYSTEMS

英文版本

Datasheet - AMPMODU Small Centerline

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

1MM-R-D09-VS-00-F-TBP

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 18 Position, 1 mm [.039 in]
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, AMPMODU Small Centerline

